

第2回 台湾-日本国際交流シンポジウム 2018年5月31日-6月1日 (第12回集積化MEMS技術研究会 第9回集積化MEMS技術研究ワークショップ)

二日目(6/1)@台湾 台北市

ポスターショートプレゼンの様子

○ 研究会

場所: Fullon Hotel Taipei East

・11:20~12:00 基調講演 年吉 洋 教授(東京大学)

“MEMS Vibrational Energy Harvester
for IoT Wireless Sensor Applications”

・12:00~13:30 休憩

・13:30~14:00 ポスターショートプレゼン(各2分予定)

・14:30~15:50 招待講演

14:30-14:50 Dr. Ralph Tsung-Hsien Lin
(TDK InvenSense Inc.)

“Miniaturized Pressure Sensor Technology
through Integrated MEMS Approach”

14:50-15:10 平本 俊郎 教授(東京大学)

“Advanced CMOS Devices for VLSI:
Present Status and Roadmap”

15:10-15:30 曾根 正人 教授(東京工業大学)

“Characteristics of Electroplated Gold Material
with Multilayer Metal Technology
for CMOS-MEMS Accelerometer”

15:30-15:50 Prof. Tim Chih-Ting Lin

(National Taiwan University)

“CMOS-NEMS Integration for Bio
and Chemical Sensing”

・15:50~16:00 休憩

・16:00~17:30 ポスターセッション

・18:30~20:00 懇親会(Fullon Hotel Taipei East)

